



Bezhalogenkowy drut lutowniczy SnPb(Ag)

Opis:

Interflux® **IF 14-06, 14-09 & 14-14** drut ołowiowy, nie wymagający czyszczenia, nie zawierający

żywic oraz halogenkowych aktywatorów zalecany do pracy jeśli wymagana jest **klasa 3** (IPC-A-610).

Aktywatory zawarte w topniku **IF 14** praktycznie w całości wyparowują podczas lutowania (nie karbonizują się na powierzchni). Pozostałości mogą być z łatwością usunięte szczoteczką.



Dostępność

Typ topnika: IF 14
Zaw.topnika: 0,6—0,9—1,4 % w/w

stop	Temp. topnienia	średnica					
		0,35	0,50	0,70	1,00	1,50	2,00
Sn60Pb40	183°C—191°C	•	•	•	•	•	•
Sn63Pb37	183°C	•	•	•	•	•	•
Sn62Pb36Ag2	179°C	•	•	•	•	•	•
Sn60Pb38Cu2	183°C-191°C	•	•	•	•	•	•

• = standard

• = na żądanie

Główne zalety

- Minimalne zanieczyszczenie narzędzi w związku z niską zawartością topnika
- Niewielki, nielepki osad z łatwością usuwany ręcznie
- Bezkalafoniowe opary
- Klasyfikacja IPC & EN: **RE LO**
- 100% bezhalogenkowy
- Długie życie grota
- Wieloletnia obecność na rynku
- Bardzo dobra zwilżalność Cu, Ag, Sn ...



Instrukcja pracy

Lutowanie ręczne

Zalecana temperatura grotu pomiędzy 320°C - 360°C. Dla trudniejszych powierzchni jak Ni temperatura do 400°C.

Istotne jest użycie solidnej stacji lutowniczej, która ma szybki czas nagrzewania i odpowiednią moc.

Wybierz odpowiedni grot lutowniczy aby zredukować rezystancję termiczną, istotne jest aby

powierzchnia kontaktu gwarantowała dobry przepływ ciepła .

Nagrzewaj pole pracy oraz element jednocześnie a następnie dołóż drut w miejsce styku padu i grotu lutowniczego, dodawaj drut sukcesywnie do momentu dobrego wypełnienia miejsca lutowania. Cynę najlepiej podawać nie bezpośrednio na grot aby zminimalizować

ryzyko rozprysku topnika i jego zbyt szybkiego odparowania!

Postępowanie

Przechowywanie

Przechowuj drut w czystym otoczeniu w temperaturze pokojowej .

Przenoszenie

Przenoś drut z uwagą i starannością aby nie spowodować uszkodzeń mechanicznych.

Bezpieczeństwo

Patrz: MSDS



Rezultaty testów

Zgodne EN 61190-1-3(2007) i IPC J-STD-004(A)

Właściwość	Rezultat	Metoda
Chemiczne		
flux designator	RE / LO	J-STD-004
	F-SW 33	DIN 8511
	1.2.3	ISO 9454
qualitative copper mirror	pozytyw	J-STD-004 IPC-TM-650 2.3.32
qualitative halide		
silver chromate (Cl, Br)	pozytyw	J-STD-004 IPC-TM-650 2.3.33
	pozytyw	TR-TSY-000078 13.1.4
spot test (F)	pozytyw	J-STD-004 IPC-TM-650 2.3.35.1
	pozytyw	TR-TSY-000078 13.1.5
quantitative halide	0,00%	J-STD-004 IPC-TM-650 2.3.35
Środowiskowe		
SIR test	pozytyw	J-STD-004 IPC-TM-650 2.6.3.3
	pozytyw	TA-NWT-000078 13.1.4
qualitative corrosion, flux	pozytyw	J-STD-004 IPC-TM-650 2.6.15
electro chemical migration	pozytyw	TA-NWT-000078 13.1.5



Opakowanie

Szpule 100g, 500g and 1000g

Nie wszystkie średnice dostępne są dla wszystkich wersji szpul

Nazwa handlowa: IF 14-06 Leaded, Halide Free, No-Clean Solder Wire
IF 14-09 Leaded, Halide Free, No-Clean Solder Wire
IF 14-14 Leaded, Halide Free, No-Clean Solder Wire

Disclaimer

Because Interflux[®] Electronics N.V. cannot anticipate or control the many different conditions under which this information and our products may be used, we do not guarantee the applicability or the accuracy of this information or the suitability of our products in any given situation. Users of our products should make their own test to determine the suitability of each such product for their particular purposes. The product discussed is sold without such warranty, either express or implied.

Copyright:

INTERFLUX[®] ELECTRONICS N.V.

Please consult the latest
version of this document
on:

www.interflux.com

This document in another
language?:

www.interflux.com